

## エレクトロニクス部会ニュース No. 3

・平成 20 年 12 月 15 日(月)

部会ニュース No.3 をお届けします。内容は来年 2 月 4 日(水)に開催予定の幹事会のご案内、12 月 8 日(月)に開催された幹事会の議事概要および 12 月 11 日(木)に開催された部会 CT・部会長合同委員会の議事概要です。

部会 CT・部会長合同委員会の主な議事内容は、部会のホームページの状況と新公益法人制度についてです。

### ( 1 ) 平成 20 年度第 6 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。議題は主として部会の継続申請と今後の部会の在り方等です。どなたでも出席できますので、どうぞご出席ください。

1. 日時：平成 21 年 2 月 4 日 (水) 14:00 ~ 18 : 00
2. 場所：住友ベークライト(株)会議室
3. 議題： 継続申請について  
今後の活動計画  
来年度シンポジウムについて 等

### ( 2 ) 平成 20 年度第 5 回幹事会

標記会議を 12 月 8 日 (月)、住友ベークライト (株) にて開催しました。主な議事内容は

化学工学会会員増強委員会委員は三平幹事から沢井幹事に交代

部会ニュース担当は荻野部会長

年会のエレクトロニクスセッションは 3 件の発表で、3 月 18 日(水)15:20 ~ 16:20 の予定

部会のホームページに掲載する研究項目の概要(部会ニュース No.1 所載の旧版を修正:下記参照)の決定

来年度シンポジウムはエネルギー関連の予定等です。

### 部会のホームページに掲載する研究項目

1. 微細加工 (マイクロプロセッシング) 技術：  
半導体素子を実装するマイクロデバイスの高性能化には、微細回路形成プロセスが不可欠となっている。この分野に対し、銅めっき、エッチング、化学的/機械的表面研磨 (CMP)、インクジェット、薄膜形成等のマイクロプロセッシング技術を微細回路形成プロセスに展開するため、電気化学工学、微粒子工学、流体工学、反応工学等の立場から調査研究開発する。
2. 放熱 (ヒートディスチャージ) 技術と材料技術：  
半導体の高密度・高性能化に伴い、マイクロデバイスは発熱密度が増大し、高放熱プロセスが不可欠となっている。この分野に対し、複雑構造体の非線形熱伝導解析等の熱伝導理論と材料技術を高放熱プロセスに展開するため、伝熱工学の立場から調査研究開発する。
3. 模擬計算 (マイクロシミュレーション) 技術：  
半導体素子を用いて、高度なデバイスやシステムを構築するには、有機・無機材料を高度に複合化す

る高信頼性設計プロセスが不可欠となっている。この分野に対し、樹脂流動解析、イオンの物質移動理論等のマイクロシミュレーション技術を高信頼性設計プロセスに展開するため、流体工学、拡散工学、微粒子工学等の立場から調査研究開発する。

4. **界面相互接続（インターコネクション）技術：**

マイクロデバイスには、さまざまな界面が存在し、密着・接続・接合強度を確保する高接合強度発現プロセスが不可欠となっている。この分野に対し、有機・無機の相互接着理論、接着剤、多層化、真空・熱・超音波接合技術等のインターコネクション技術を高接合強度発現プロセスに展開するため、界面制御工学の立場から調査研究開発する。

5. **環境持続可能（サステナビリティ）技術**

上記の技術推進において、環境に配慮した材料・プロセスを追及する省エネルギー・低環境負荷プロセスが不可欠となっている。この分野に対し、リサイクル技術、鉛フリーはんだ技術、レアアース代替技術、センシング技術等のサステナビリティ技術在省エネルギー・低環境負荷プロセスに展開するため、環境化学工学の立場から調査研究開発する。

**（3）H20 年度第 2 回部会 CT・部会長合同委員会**

標記会議が 12 月 11 日（木）化学工学会会議室にて開催されました。議事内容は次の通りです。

(1)本部ホームページの改訂版の紹介

プロジェクトで映しながら説明があった。

(2)各部会のホームページの更新状況の報告

各部長より報告があった。エレクトロニクス部会にははばき先生作成の資料(12月8日幹事会で回覧)に沿って報告した。各部会の HP をプロジェクトで映しながらの報告であったが、**正直言ってエレクトロニクス部会の HP は若干見劣りがした。**

(3)本年度の年間部会活動報告書等の提出依頼

締切は 2009 年 1 月 30 日(金)。

(4)本部サーバの利用方法と使用料金の改定

部会は従来通り年間 3 万円。新たに分科会がサーバ利用を希望すれば年間 1.5 万円だとのこと。

(5)新公益法人制度について

公益社団法人の要件：公益目的事業支出 総事業支出の 50%

遊休財産額(内部留保 = 繰越金) 公益目的事業支出

しかし、従来は遊休財産額(内部留保 = 繰越金) 総事業支出の 30%という指導があった。今後この指導はどうなるかわからないが、部会全体の現状は平成 19 年度で事業支出 33.6 百万円に対し、繰越金は 56.5 百万円 (エレクトロニクス部会は事業支出 2,269 千円に対し、繰越金 5,318 千円) であり、**繰越金を特定資産(簡単にいえば「----積立金」)にする必要がある**とのこと。

(6)その他

NEDO のテーマ公募型事業の説明と第 74 年会(横浜国大)についてのアナウンスがあった。

以上